

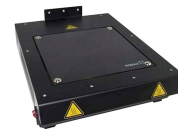
# Infrarot-Rework-Heizplatte, 230 V, 800 W - Ersa 0IRHP100A-03

**Artikel-Nr.** ER-0IRHP100A-03 **Hersteller** Ersa  
**Hersteller-Nr.** 0IRHP100A-03 **EAN** 4003008084276

Infrarot-Heizplatte zum unterseitigen Vorheizen von Leiterplatten beim manuellen Löten, Entlöten und in der Nacharbeit. Die leistungsstarke 800-W-Infrarottechnik senkt die nötige LötKolbentemperatur und schont so die Baugruppen. Die Steuerung erfolgt direkt über eine Lötstation i-CON1 C oder i-CON2 C, ohne zusätzliches Steuergerät.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b>  |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>              |
| Ausführung            | <b>TEC</b>              |
| ESD-Ausrüstung        | <b>ESD Lötstationen</b> |
| Gewicht               | <b>0.1 kg</b>           |
| Ursprungsland         | <b>Deutschland</b>      |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Die Infrarot-Heizplatte Ersa 0IRHP100A-03 ermöglicht das unterseitige Vorheizen von Leiterplatten beim manuellen Löten und Entlöten sowie in der Nacharbeit. Die kontaktlose, leistungsstarke Infrarottechnik senkt die nötige Betriebstemperatur von LötKolben, innenbeheizter SMD-Entlötpinzette oder Entlötkolben - niedrigere Spitzentemperaturen verringern die Gefahr von Leiterplattenschäden und verlängern zugleich die Spitzenstandzeit deutlich.

Die Steuerung erfolgt direkt über eine Lötstation der Type i-CON1 C oder i-CON2 C (passenden Schnittstellenanschluss beachten), sodass kein zusätzliches Steuergerät benötigt wird. An der Station lassen sich optional weitere Löttools betreiben, etwa der LötKolben i-TOOL (150 W), die innenbeheizte SMD-Entlötpinzette CHIP TOOL (2 x 30 W) oder der X-TOOL (120 W). Das große Digitaldisplay und die menügeführte Bedienung der i-CON C bieten maximale Prozesskontrolle in 10 Sprachen.

## Merkmale

- Kontaktloses Vorwärmen von Baugruppen beim bleifreien Handlöten
- Vorwärmen von SMD-Bauelementen
- Reflowlöten einseitig bestückter Platinen
- Trocknen von Pasten und Klebern
- In sechs Stufen regelbare Heizplatte

## Anwendungen

- Vorwärmen von SMD-Bauelementen und Baugruppen
- Aushärten und Trocknen von Pasten, Lacken und Klebern
- Reflowlöten einseitig bestückter Platinen
- Vorwärmen von BGA-Bauelementen zur Vermeidung des Popcorning-Effekts
- Gleichmäßige BGA-Erwärmung für Reballing-Anwendungen

## Technische Daten

Heiztechnik Infrarot, kontaktlos

Leistung 800 W

Spannung 230 V

Heizfläche 125 x 125 mm

Regelung sechs Stufen

Steuerung über Lötstation i-CON1 C oder i-CON2 C